

技術詞彙表

於本通函中，除非文義另有所指，否則本通函所用與目標集團及其業務有關之若干詞彙的解釋及定義具有下文所載的涵義。該等詞彙及其涵義未必與該等詞彙的標準行業涵義或用法相同。

「三維點雲」	指	三維坐標點(X、Y、Z)的結構化集合，表示三維空間中的對象或場景，通常會附加顏色、強度及時間戳記等屬性。其為物理環境的高精度數字繪圖，亦是數字孿生、自動駕駛及工業檢測等應用的基礎
「ADAS」	指	高級駕駛輔助系統，ADAS旨在輔助駕駛員操作車輛及安全駕駛，通過利用各種傳感器、攝像機及軟件算法，提供額外功能並提升駕駛體驗
「ADC」	指	模數轉換器，ADC是將連續模擬信號轉換為離散數字信號的芯片，其核心功能是作為模擬信號和數字系統之間的接口，使主芯片等數字設備能夠處理模擬信號
「ADS」	指	自動駕駛系統，ADS是一種軟硬件解決方案，可在界定的運行設計域(ODD)內持續執行整個動態駕駛任務(DDT)，符合SAE J3016 3至5級自動駕駛汽車操作標準
「車規級」	指	適用於車輛的元件或產品必須符合的標準，其通常要求在不同溫度、濕度等駕駛條件下均實現穩定可靠的高性能，以及接近零故障率和具備長生命週期，其亦要求產品供應商能實現量產
「車規級激光雷達 解決方案」	指	符合車規級質量標準且專門設計以集成到車輛的激光雷達解決方案

技術詞彙表

「BEV」	指	純電動汽車，BEV是指完全依靠電池動力運行的汽車
「設計定案」	指	製造商選中非同質化、不可互換封裝元件的封裝過程
「探測距離」	指	根據中國汽車工業協會起草的《車載激光雷達檢測方法》，激光雷達能以高於50%檢出概率檢測出具有特定反射率的2米×2.5米物體的最大距離
「視場角」	指	視場角，傳感器捕獲場景的角度大小，以垂直和水平角度範圍測量
「FPGA」	指	現場可編程門陣列，FPGA是一種可編程半導體器件，允許用戶根據需求靈活配置其內部邏輯結構，實現定製化的數字電路功能。其核心特徵是硬件可重構性，提供通用處理器的靈活性，同時以專用集成電路(ASIC)的效率執行特定任務
「圖像級」	指	適用於要求高分辨率($\geq 12MP$)、低噪聲(SNR >40dB)及寬動態範圍(WDR)成像系統的品質標準，通常應用於醫療診斷、自動駕駛汽車及消費電子產品
「激光雷達」	指	激光探測與測量，一種運用脈衝激光束實時測量物體到目標表面可變距離的傳感技術
「L2+」	指	駕駛自動化的等級，2+級指部分自動化，即提供組合駕駛輔助功能，其超過2級解決方案的功能且非常接近3級解決方案的功能
「量產」	指	非原型產品的裝運和交付

技術詞彙表

「NT 2.0」	指	NIO Technology 2.0，蔚來第二代專有整車平台架構，將硬件、軟件、通信、車電系統和動力總成集成到一個統一且高度可擴展的系統中
「NT 3.0」	指	NIO Technology 3.0，蔚來第三代專有整車平台架構，NT 2.0的升級版
「主機廠」	指	原始設備製造商，即生產專用於新車的零部件公司
「檢出概率」	指	檢出概率，按接收回波的實際數量除以理論可接收回波的數量計算
「分辨率」或 「激光雷達分辨率」	指	掃描光束的最小間隔，通常以角分辨率表示
「RFP」	指	需求方案說明書，由汽車製造商、出行服務提供商或政府單位發佈的正式邀約文件，邀請供應商提交自動駕駛系統的技術及商業方案，這些方案涵蓋硬件(如激光雷達)、軟件(如感知算法)或整合的交鑰匙解決方案
「ROI」	指	感興趣區域，指激光雷達視場角內特別關注或要求較高探測準確度的區域。該區域的點雲密度高於普通視場角
「半固態掃描」	指	一種結合機械及固態部件(例如MEMS鏡面或旋轉棱鏡)的混合掃描技術，可在激光雷達及工業檢測等應用中實現激光束轉向、平衡精確度與成本效益

技術詞彙表

「TI芯片」	指	德州儀器芯片，由德州儀器(TI)設計及製造的集成電路，包括模擬芯片(如電源管理IC)、嵌入式處理器(如DSP)及傳感器，廣泛應用於汽車、工業及物聯網應用
「V2X」	指	車聯網，一種能夠讓車輛與外界交通環境(包括車輛、基礎設施、行人及互聯網)進行交互的技術
「VCSEL」	指	垂直腔面發射激光器，一種基於半導體的激光二極管，垂直於頂面射出激光
「量產」	指	通過優化流程進行逾10,000件的大規模標準化產品製造，以實現成本效益及品質一致性，通常由指標界定，一般通過行業認證進行驗證